

「複合加工と自動化」のため工夫を

長谷川機械製作所

小型旋盤やMCを得意とする長谷川機械製作所（E7051、さいたま市見沼区、長谷川透社長）も好調の中でJIMTOF2026を迎える。長谷川大晃取締役は「今春から産業用ロボットやヒト型のヒューマノイドロボット、半導体関連、光学機器分野に加え、樹脂加工全般で需要が高まる。最近はより活発化しており、勢いを加速させて、JIMTOFを迎えたい」と話す。

同社は「大は小を兼ねない」をコンセプトに、小型ながら高速で高精度加工ができる製品を得意としてきた。コンパクトな設置面積とロボットやローダーを使った自動化対応で、従来は自動車部品などの加工ライン向けに定評があった。しかし、この6年ほどで状況は変わった。製造現場の柔軟性向上のため、1台で多くの工程をカバーできる複合加工機の人気が高まる。

そこで、「複合加工と自動化」を今回展のテーマとした。目玉は新製品だ。対向2スピンドルで16カ所に切削工具を搭載できるタレットを2つ備えた複合加工機「CW52MY Plus（プラス）」を初披露する。既存製品でも、旋削機能を備えた5軸MC「PM320-5XT」と産業用ロボットを組み合わせ、自動化システムとして提案する。

自律化や自動化が進むと、工作機械は長時間にわたり無人運転するようになる。長谷川取締役は「精度不良や加工トラブルを未然に防ぐ取り組みがより一層求められる。そこで、わが社

は機械構造の作り込みを重視する」と話す。同社製品は加工室内に切りくずがとどまりにくい構造とし、全面をステンレスカバーで覆う。旋盤向けには振動切削や高圧クーラント装置など、切りくずを細分化するためのオプションも複数用意する。また、日常点検が必要な機器類は機械後方などの一面に集約して、メンテナンス作業の省力化も図る。

長谷川取締役は「それらの工夫は加工ライン向けの製品で顧客に鍛えられた結果。その知見と複合加工を組み合わせた集大成をブースでお見せしたい」と意気込む。

前後工程との連携のしやすさをPR

西部電機

西部電機（E2015）は、「～いいもの創ろう Seibu（セイブ）から～」を展示コンセプトに掲げる。油加工液仕様のワイヤ放電加工機「M35LP」とワイヤ放電加工機「MM75UP」を出展する。

M35LPは加工ストロークをX軸350mm×Y軸300mm×Z軸170mmと従来機より拡大し、より大型の精密部品の加工に対応する。M35LPはピッチ加工精度が $\pm 1.0\mu\text{m}$ と高く、近年需要が拡大している半導体やデータセンター、AIなどの成長分野からの引き合いが増えている。

精密機械事業部で副事業部長と生産部長を務める光安隆執行役員は「M35LPとMM75UPは日本国内向けには既に発売したが、海外ではこれから。JIMTOFは海外からの

来場者も多いため、いち早く製品を知ってもらえる良い機会になる」と話す。実機展示に加え、同社のワイヤ放電加工機のフラッグシップ機「MEX（メックス）15」の性能をパネルで紹介する他、光ファイバー通信用のコネクター部品「MTフェルール」に関するサンプルワークも披露する。

同社の放電加工機には独自開発したオープンソースのインターフェースを



長谷川機械製作所の長谷川大晃取締役



長谷川機械製作所の新製品「CW52MY Plus」（提供）